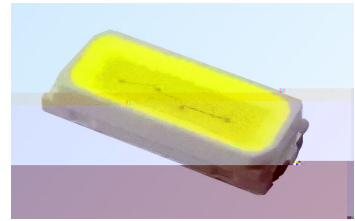


林德顺

HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM

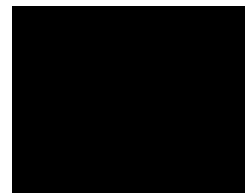
Features 特征

- Package (封装).
- Wide beam angle (宽的发光角度).
- Suitable for all SMT assembly and welding processes (适用于所有的SMT组装和焊接工艺).
- Suitable for carrier and reel (适用于载带及卷轴).
- Moisture protection level (防潮等级 Level 4).
- Package quantity 4000PCS per reel (包装每卷4000PCS).
- RoHS certified (RoHS 认证).



Description 描述

白光LED由蓝光芯片与荧光粉激发而成



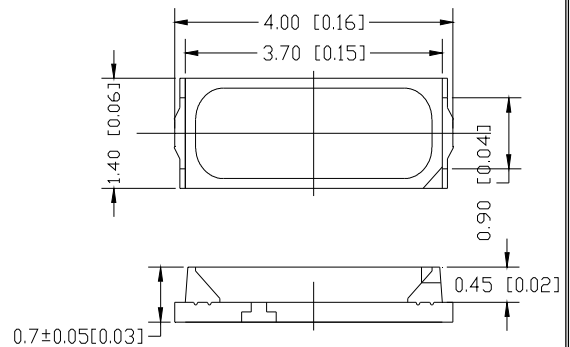
A"#\$"%&'()*+,-./:;<=>?@AB

注意：操作时应注意静电敏感
释放设备装置

Applications 应用

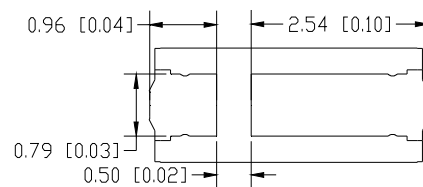
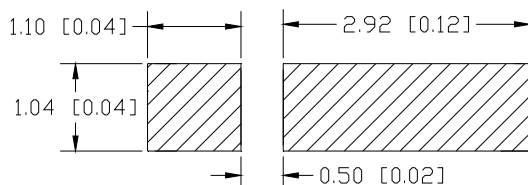
- Optical indicator (光学指示).
- Indoor display (室内显示).
- Automotive lighting (汽车照明).
- LCD backlight, converter, switch and mark, display, etc. (LCD背光、转换器，开关和标志，显示器等).
- (Used for fluorescent tubes) (用于日光灯管).
- (General application) (一般应用).

Package Dimensions 封装尺寸



Recommended Soldering Pattern

建议焊盘尺寸图



(备注)

(所有标注尺寸单位为毫米)。

(除特别标注外，所有尺寸允许公差±0.15mm)。

Selection Guide 选择指南

型号	芯片材料	胶体类型

Mass Production list 批量生产目录

型号	()	()	()	()	()	测试条件

(参数) (符号) (最小) (平) (最大) (单位)



HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM

A. Absolute Maximum Ratings at "a+2, -) 绝对最大额定值

(参数)	(符号)	(值)	(单位)
(功耗)			
(正向电流)			
(峰值正向电流)			
(反向电压)			
(静电)			
(操作温度)			°C
(保存温度)			°C
(热阻			°C/
结温			°C

(备注)

(脉宽0.1ms, 周期1/10)

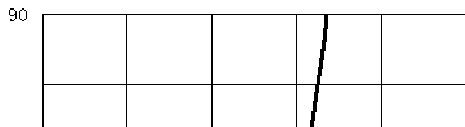
Optical characteristics curves 典型光学特性曲线

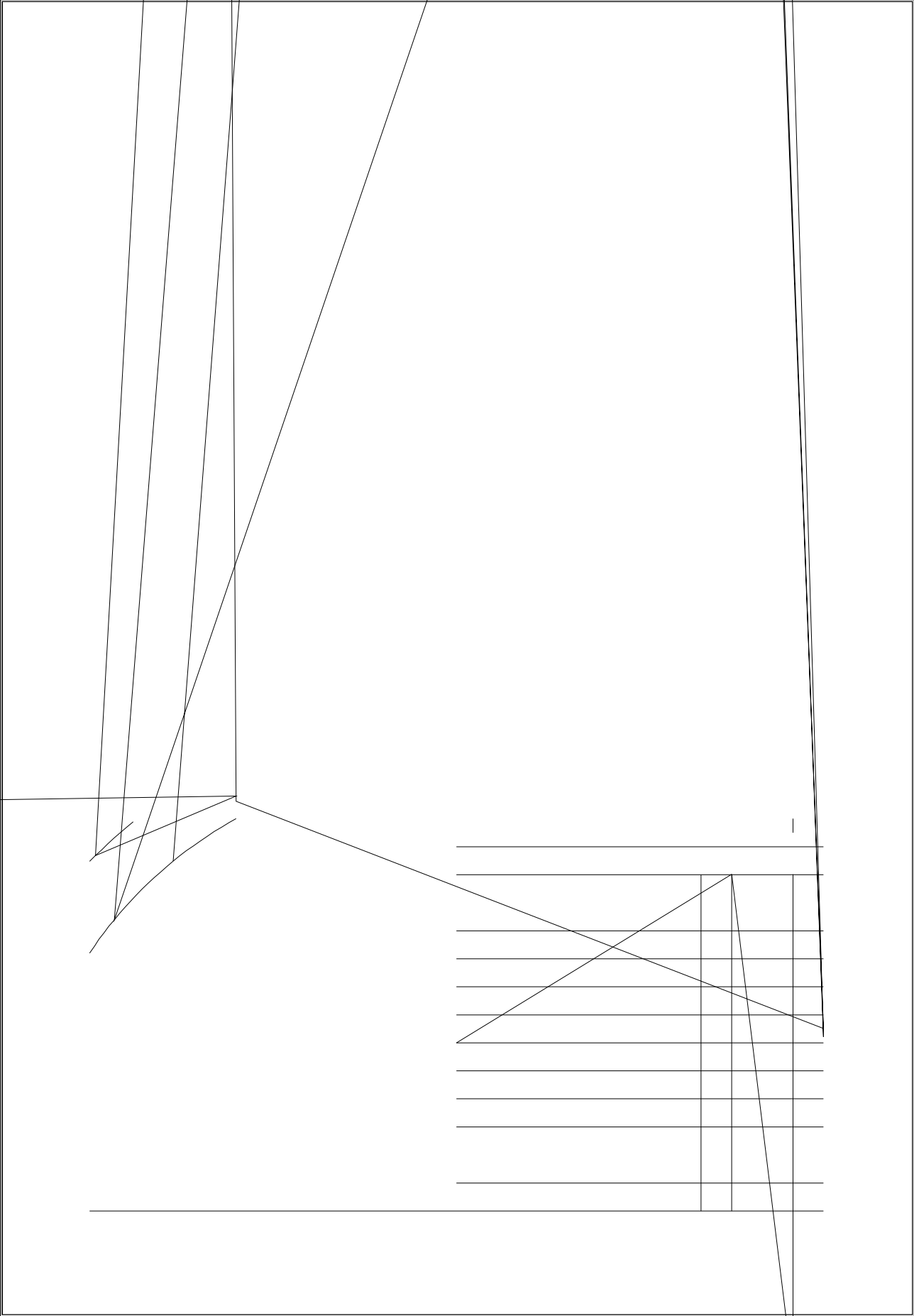
温度与正向电流特性曲线

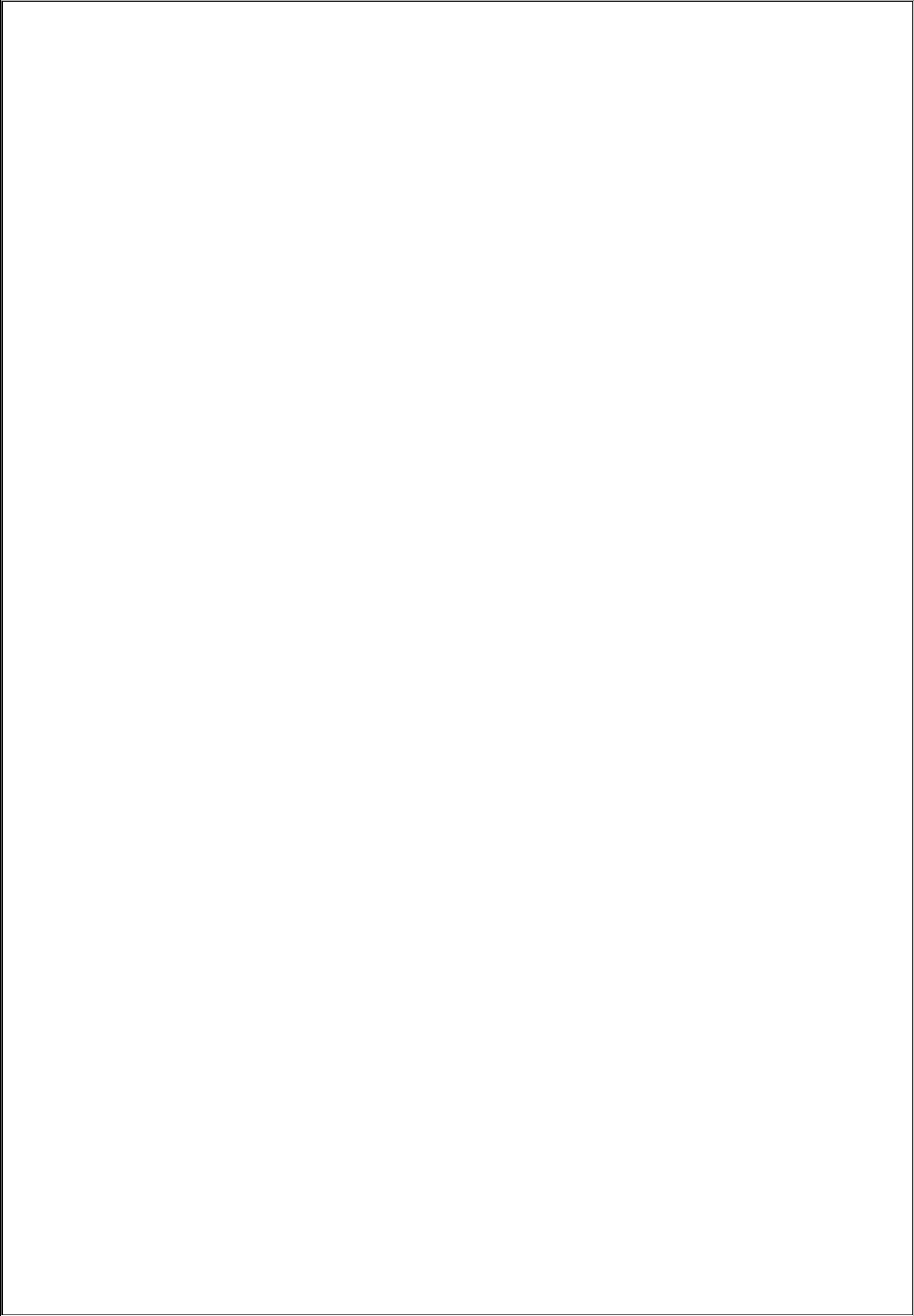
正向电流与相对光强特性曲线

正向电压与正向电流特性曲线

环境温度与相对光强特性曲线









色温

HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM

Reliability Test Items And Conditions 可靠性测试项目及条件

项目	参考标准	测试条件	时间	数量	接收/拒收
回流焊		℃			
温度循环		℃ ℃ ℃ ℃			
高温保存		℃ ℃			
低温保存		℃ ℃			
常温通电		℃ ℃			
高温高湿通电		℃ ℃			

Failure Criteria 失效

项目	符号	测试条件	判定标准	
			最小	最大
正向电压				
反向电流				
光通量				

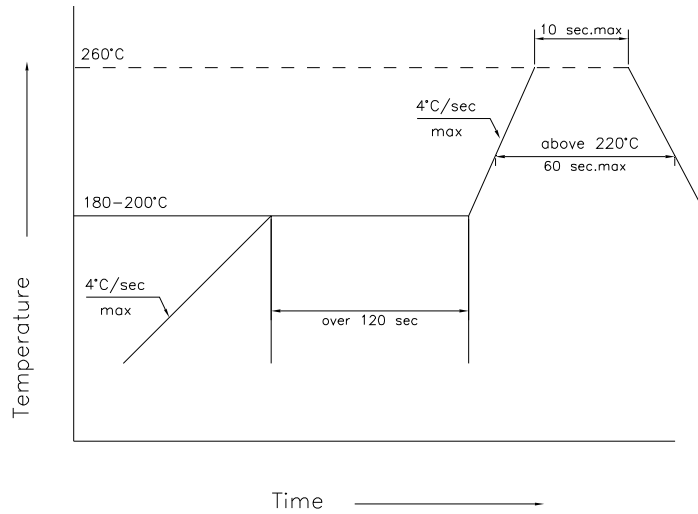
... : 规格上限 ... : 规格下限

*

数据工作表中所示的技术信息仅限于典型特征和电路实例引用的产品.它既不构成工业特性的保证,也不构成任何许可的授权.

HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM

SM" Re3lo4 Soldering %nstr!ctions SM"回流焊说明



，回流焊不可以做两次以上

当焊接时，不要在材料受热时用力压胶体表面

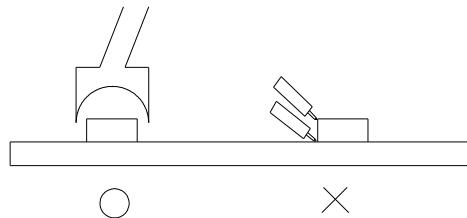
Soldering iron 烙铁焊接

当手工焊接时，烙铁的温度必须小于300°C，时间不可超 3秒

手工焊接只可焊接一次

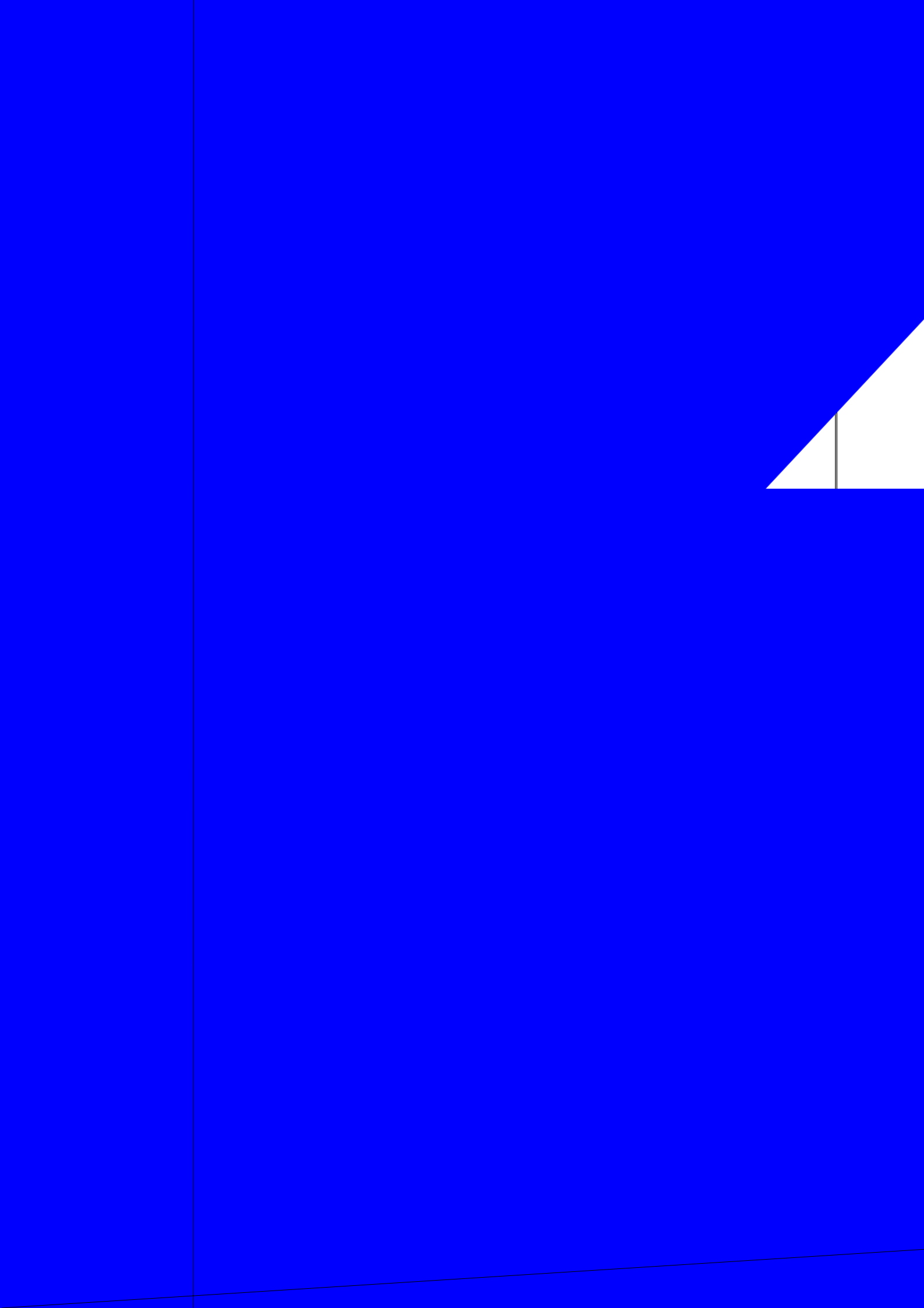
Repairing 修补

LED回流焊后不应该修复，当修复是不可避免时，必须 用双头烙铁（如下图），但必须先确认 种方式会或不会损坏LED本身的特性。



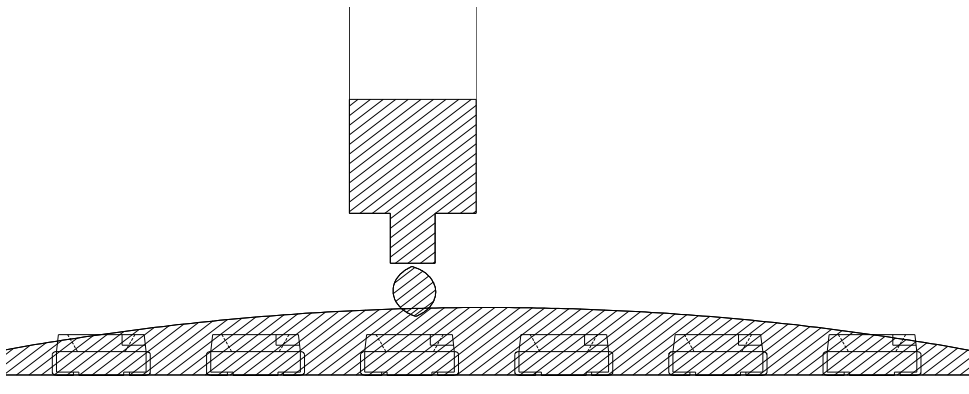
Precautions 注意事项

LED封装为硅胶，故LED胶体表面较软，用力按压胶体表面会影响LED可靠性，因此应有预防措施避免在封装的零件上的强大压力，当用吸嘴时，胶体表面的压力应是恰当的。



LED工作环境及与LED适配的材料中硫元素及化合物成份不可超 100PPM

当我们需要用外封胶涂抹LED产品时，应确保外封胶与LED封胶水相匹配，因为大多数LED的封胶水为硅胶，它有较强的氧化性和较强的吸湿性，必须防止外封材质进入LED内部以成LED的损伤，单一的溴元素含量要求小于900PPM，单一氯元素含量要求小于900PPM，在涂抹LED产品时要求外封胶溴元素与氯元素总含量必须小于1500PPM



其它注意事项请参照我们的LED 用户手册

